

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

[Hersteller von Aluminium-Leiterplatten](#)

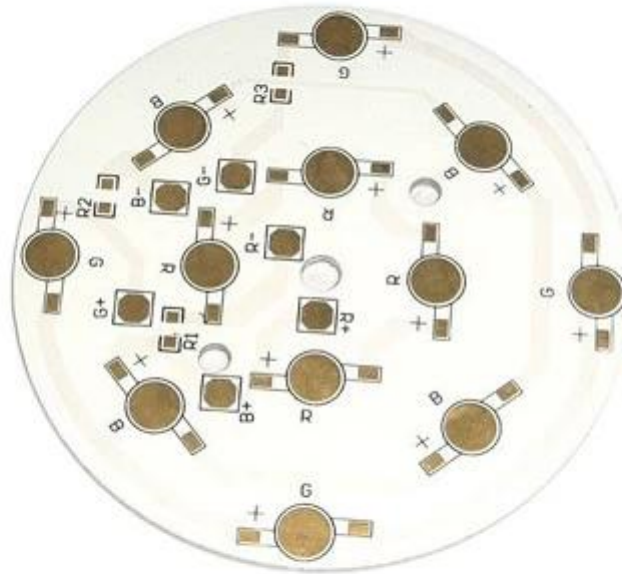
KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN : [Aluminiumbasis Leiterplatte Hersteller China](#)

Produktbeschreibung

PCB P / N.	LC057-V1
Ebenenanzahl	1L.
Material	Basiskeramik
Board thk	1,6 mm
Kupfer thk	11oz
Kleinste Lochgröße	/.
Anzahl der Löcher (Stk.)	/.
Linie w / s	15mil
Impedanzregelung. J / N (Tol%)	N.
Oberflächenveredelung	ENIG (Au: 0,05 um)
Lötmaske Siebdruck	Weiß / N / A.
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): 89; Dim Y (mm): 175
Panelisierung	Dim X (mm): 89; Dim Y (mm): 175; Anzahl der USV: 1
Besondere	N.
Routing / Stanzen	CNC



www.o-leading.com

Hochwertiger Hersteller von Aluminium-Leiterplatten

Unser Team





Zertifizierungen



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [eCRP Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp			UL796		
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
Huileyer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
Huileyer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

Implications: Using this information to verify the accuracy of the data is the user's responsibility. ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component



Test Report

No. CAVE1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Hexabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Heptabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Octabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Nonabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Decabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new SGS Certification Services. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing industry. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing industry. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing industry.

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller
Lieferdetail	7-12 Tage



FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → innerer Trockenfilm → inneres Ätzen → innerer AOI → Mehrfachbindung → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → äußeres Ätzen → äußerer AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.